

产品介绍

产品介绍 Product Presentation

厚铜电源板 (Thick Copper Power Board)

技术指标 (Specification)

层数	12层
板厚	3.5mm
铜厚	60 μ
Layer count	12layers
Board thickness	3.5mm
Cu thickness	60 μ

特点 (Characteristic)

材料	环氧玻璃布 (低热膨胀系数)
表面处理	沉金
Base materials	FR 4 (Low CTZ)
Surface finish	Immersion Gold



高温板 (High Tg Board)

技术指标 (Specification)

基板材料	Arlon 85N
常态温度	280° C
表面处理	沉金
Base materials	Arlon 85N
Normal temperature	280° C
Surface finish	Immersion Gold

特点 (Characteristic)

适用于井下探测、野外作业等高温恶劣环境

Applicable to underside of the well, outside work, high-Low temperature environment



化学镀金板 (ENIG Board)

技术指标 (Specification)

铜层厚度	3-6微米
金层厚度	0.05-0.12微米
存储时间	24个月
Nickel thickness	3-6 μ m
Gold thickness	0.05-0.12 μ m
Storage validity	24 months

特点 (Characteristic)

表面平整, 适用于高密度SMT, 有一定耐磨性

Surface is flat and level, suitable for high density SMT, have certain abrasion resistance w temperature environment



产品介绍

产品介绍 Product Presentation

混合介质层压板 (High Frequency and Mix Dielectric Board)

技术指标 (Specification)

基板材料	Rogers4350+FR4
层数	8层
板厚	2.5mm
表面处理	沉金

特点 (Characteristic)

Base materials	Rogers4350+FR4
Layer count	8layers
Board thickness	2.5mm
Surface finish	Immersion Gold



陶瓷基板 (Ceramic Base Board)

技术指标 (Specification)

基板材料	Ceramic
板厚	0.5-3.0mm
层数	1-18层
表面处理	沉金/喷锡/抗氧化/沉银
Base materials	Rogers/Taconic
Board thickness	0.5-3.0mm
Layer count	1-18layers
Surface finish	ENIG/HAL/OSP/Silver

特点 (Characteristic)

保证高频信号传输质量

Assure the transmission quality of high frequency



特性阻抗板 (Impedance Controlled)

技术指标 (Specification)

一般批次	50-1000
控制精度	$\pm 1.0\%$
测试精度	500 1.0%
General impedance	50-100ohm
Control precision	$\pm 1.0\%$
Test precision	500ohm $\pm 1.0\%$

特点 (Characteristic)

保证高频或高速信号传输质量

Ensure the quality of high frequency or high logic signal transmission



产品介绍

产品介绍 Product Presentation

BGA塞孔板 (Plugged Vias Board)

● 技术指标 (Specification)

可封端孔径	0.25-0.8mm
孔封端深度	30%-100%
封端材料	双组分感光油墨
Hole diameter	0.25-0.8mm
Depth	30%-100%
Material	LP2

● 特点 (Characteristic)

防止BGA引脚之间的相互短路, 适用于高密度SMT封装

Assured quality, Protects BGA against shorts



金手指卡板 (Gold Finger Board)

● 技术指标 (Specification)

基板材料	FR4
表面处理	喷锡+金手指
镀金厚度	0.3-0.5微米
Base materials	FR4
Surface finish	HASL+Gold Finger
Au	0.3-0.5um

● 特点 (Characteristic)

电镀金工艺, 金层厚度高适用于经常插拔的实用环境

Excellent wettability, Reliable technology, applicable to the regular cut-in or pull out working condition



金属基板 (Metal Base Board)

● 技术指标 (Specification)

材料	铝基/铜基
层数	1-2层
板厚	0.5-5.0mm
表面处理	沉金/喷锡

Base materials	Al/Cu
Layer count	1-2layers
Board thickness	0.5-5.0mm
Surface finish	Immersion Gold/HAL
Material	PITC, Ventec, Bergquist and domestic



产品介绍

产品介绍 Product Presentation

柔性电路板 (FPC)

● 技术指标 (Specification)

基板材料	聚酰亚胺或聚酯
阻焊	油墨或覆铜膜
表面处理	沉金、喷锡、抗氧化、沉银
成型	模具

Base materials	PI/Dupont
Solder mask	Printing Ink
Surface finish	ENIG
Shel	matrix

● 特点 (Characteristic)

体积小, 重量轻可弯曲折叠使用

Small cubage low weight and can foldable



刚柔结合板 (Rigid-flex Board)

● 技术指标 (Specification)

基板材料	聚酰亚胺+FR4
阻焊	油墨或覆铜膜
表面处理	沉金、喷锡、抗氧化、沉银
成型	模具

Base materials	PI+FR4
Solder mask	Printing Ink
Surface finish	ENIG
Shel	matrix

● 特点 (Characteristic)

体积小, 重量轻可弯曲折叠使用

Small cubage low weight and foldable



刚柔结合板 (Rigid-flex Board)

● 技术指标 (Specification)

基板材料	聚酰亚胺+FR4
阻焊	油墨或覆铜膜
表面处理	沉金、喷锡、抗氧化、沉银
成型	模具

Base materials	PI+FR4
Solder mask	Printing Ink
Surface finish	ENIG/HAL/OSP/silver
Shel	matrix

● 特点 (Characteristic)

体积小, 重量轻可弯曲折叠使用

Small cubage low weight and foldable

